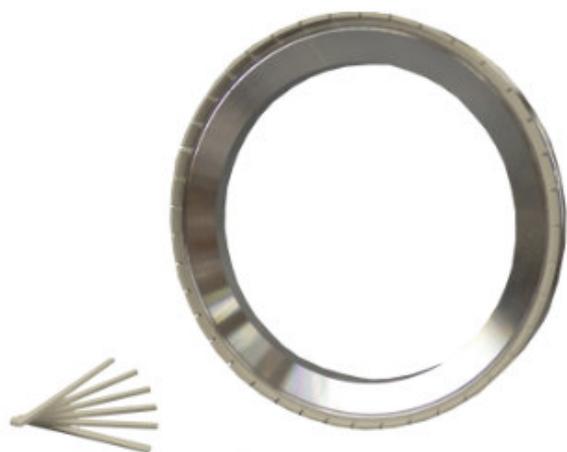


# NANOSTRU WHEELS

ナノストラホイール



## お客様のご要求

パワー半導体用ウエハの加工において

- ・ 潜傷を浅くしCMP量を減らしたい
- ・ 平滑性、表面あらさを良くしたい
- ・ 高能率で加工したい

そんなホイールが出来ないか？



## ナノストラホイールを開発！

## NANOSTRUの特長

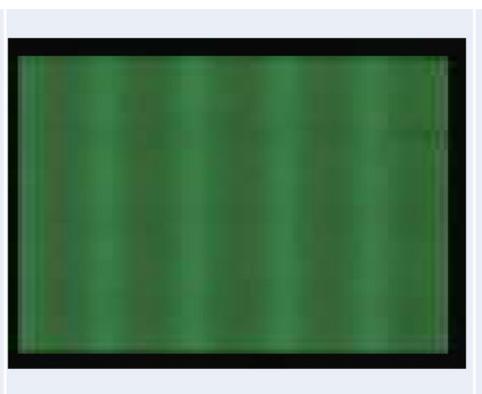
- ◆ サブミクロン原材料を高分散配合  
砥粒の凝集を抑制し砥粒・結合剤・気孔の最高クラスの均一分散を実現
  - ・ 潜傷の低減と平滑・表面あらさの向上
  - ・ サブミクロンサイズの砥粒における高加工レートを実現

## 適用粒度

結合剤	特殊ファイナセラミックスボンド <sup>®</sup> NS08 (超仕上)
粒度	#2000～#50000

## 研削例

研削形態：ロータリーインフィード研削  
被削材：SiC ウエハ 4インチ  
使用砥石：SD #50,000  
加工結果：潜傷深さ 1  $\mu$ m、Ra 0.5nm、加工レート 1.8  $\mu$ m/min



↑ CMP 1  $\mu$ m 除去、KOH エッチング処理後のレーザー顕微鏡画像

ZYGO による二次元面あらさ測定画像→

